



少量生産・試作実験用途向け

超小型オールインワンはんだ付装置

Ultra-small all-in-one soldering machine

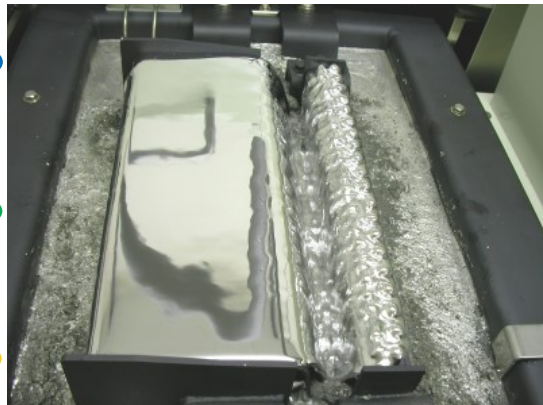
SSF-200-B3



多目的用途に使用可能

業界最小クラスのフロー槽

1個流しセル生産対応



多目的用途に使用可能

○開発・試作

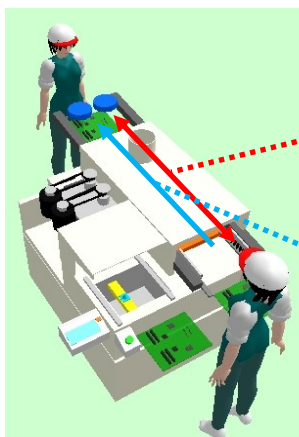
研究室に設置しても場所を取らない省スペース設計です。
数値管理で基板に合わせた最適条件設定や試作における細かい条件設定が可能です。

○少量生産・セルライン

小型基板でチップ部品はんだ付けが必要な場合や頻繁に稼働しないフロー槽の代替として最適です。
また、DIPパレットを使用すれば後付け部分のはんだ付が可能です。
簡単にレイアウト変更が可能ですので、専用セルラインが構築できます。

○用途に合わせた搬送

基板搬送方向は、フロアレイアウトや作業工程に合わせて、リターン式とスルー式を切り替えることができます。



リターン式

1名で作業する場合は冷却した後に基板を投入口に戻すことができます。

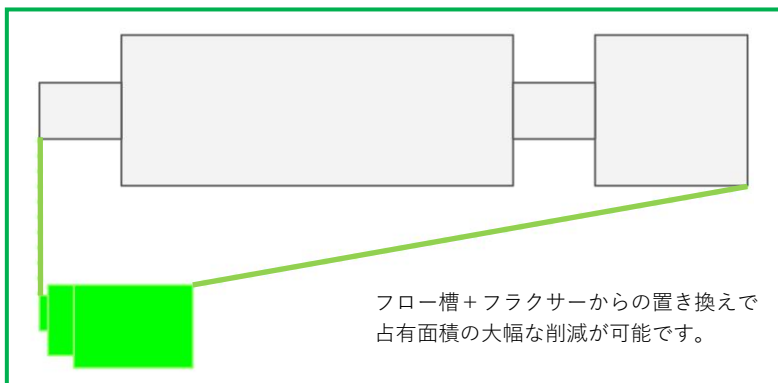
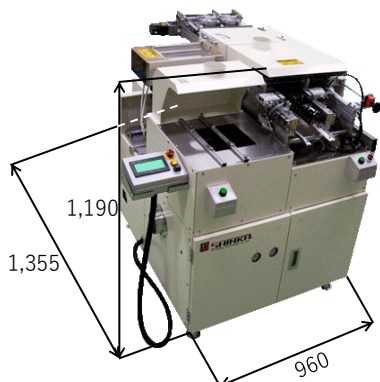
スルー式

2名で作業する場合などに使用します。
投入した基板を次工程の作業者がピックアップすることができます。

業界最小クラスのフロー槽

○高いスペース効率

小型でありながら、フラクサー・プリヒート・はんだ槽・冷却ゾーンを1台に備えているため、少ない占有面積でそのすべてを行うことができます。
また、消費電力も小さく(10kW)、環境への負荷を抑えることができます。



1個流しセル生産対応

○セル生産に対応した設備構成

作業者はスプレー側とはんだ付け側での基板着脱のみを行います。

リターン方式の場合、その場からほとんど動くことなくフラックス塗布/プリヒート/はんだ付け/冷却の工程を行うことができます。

○生産工程や基板にあわせた搬送方式を選択可能

前後の工程にあわせてリターン式とスルー式(2ページ目参照)を選択できます。

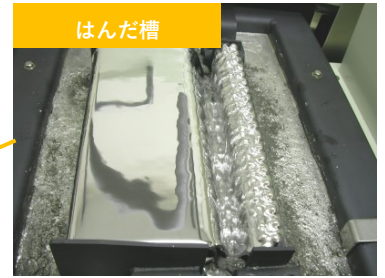
また、基板ごとに搬送速度と速度変化ポイントを設定することができます。

(例) スルーホールアップしにくい部分で速度を小さくする、プリヒートから第1波間の温度ドロップを防ぐため速度を大きくするなど

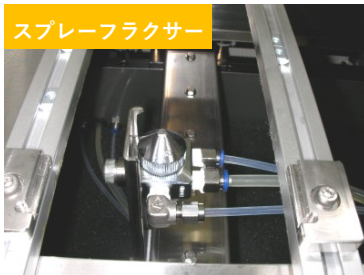
冷却ファン



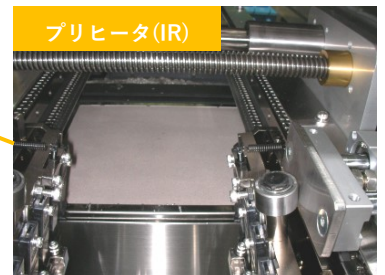
はんだ槽



スプレーフラクサー



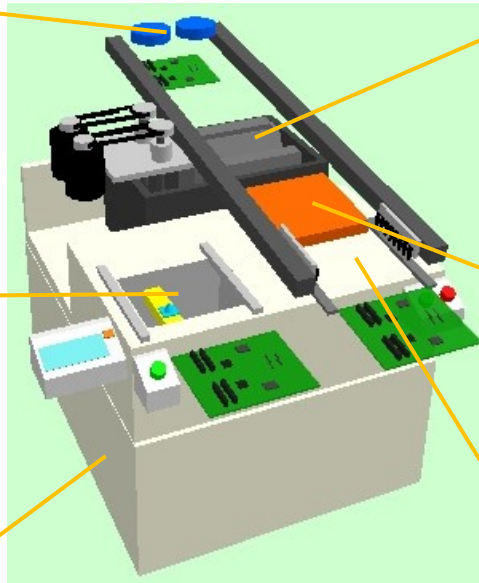
プリヒータ(IR)



フラックスタンク



搬送機



その他

○メンテナンス

はんだ槽はフラクサー側に引き出すことができます。

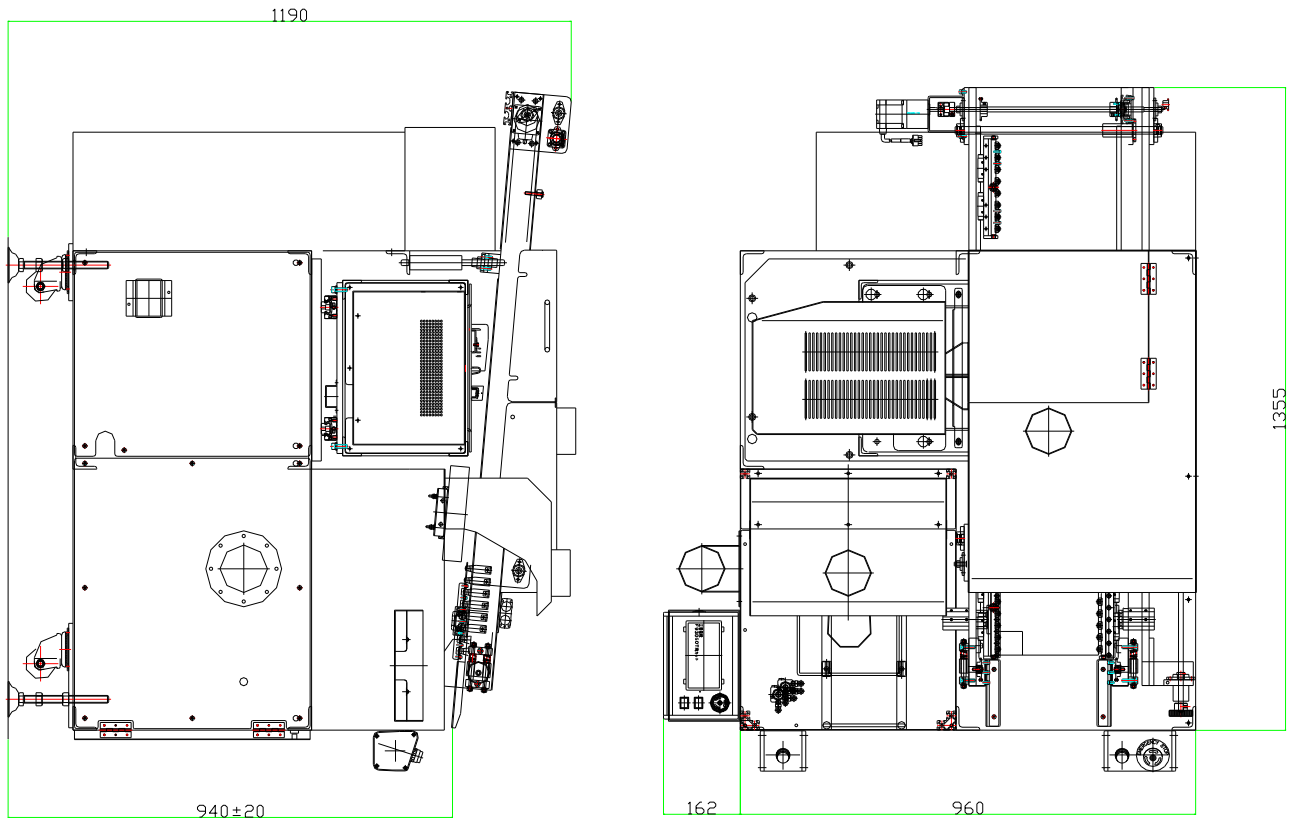
噴流ノズルも極めて小型であるため、取り扱いが容易です。

○オプション・特注

オプションについてのご質問や特注仕様のご用命は担当営業までお問合せください。



外観図



外形寸法	960(W)×1,355 (D)×1,190(H)mm
装置重量	約350kgf
ワークサイズ	外形：50(W)×50(L)mm～210(W)×230(L)mm以内 厚さ：0.8～2.3t 部品高さ制限：基板下面から6mm / 上面から50mm
スプレーフラクサ	XYロボット式 / 低压スプレー×1 / 最大100mm/sec
はんだ槽	材質：ステンレス材+カナックスーフ処理 加熱方式：間接加熱ヒータ(1.2kW×6) 引き出し方式：手動ハンドル
はんだ容量	約170kgf(鉛フリーはんだ)
プリヒータ	IR(遠赤外線)パネルヒータ / 1kW
搬送	搬送方式：基板チャック移動 搬送角度：5°C 幅変更方式：手動ハンドル
冷却機構	上部クロスフローファン
登録機種数	100機種
電源・エアー	3相200V / 50A 0.5MPa / クリーンエアー



F A シンカテクノロジー株式会社

福島事業所

〒960-8163 福島県福島市方木田字前白家9-11
TEL 024(504)1188 FAX 024(502)1190

十和田R&Dセンター 〒034-0107 青森県十和田市洞内字樋口78-1122
TEL 024(522)5440 FAX 024(522)6570